

Штаб-квартира расположена в Индустриальном и научном парке Синьчжу (Тайвань); подразделения имеются в Китае, Дании, ОАЭ, Индии, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Великобритании, США и Швеции. Компания имеет тесные связи с тайваньским контрактным производителем TSMC.

Операционная прибыль	43,2 млрд NT\$ (31 декабря 2020) ^[2]
Чистая прибыль	41,4 млрд NT\$ (31 декабря 2020) ^[2]
Активы	534 млрд NT\$ (31 декабря 2020) ^[2]
Капитализация	1,78 трлн NT\$ (18 февраля 2022) ^[3]
Число сотрудников	17 377 чел. (30 апреля 2021) ^[2]
Дочерние компании	Airoha Technology Corp. EcoNet Wireless ILI Technology Corp. MStar Semiconductor Nephos Inc. Richtek Technology
Сайт	mediatek.com



Медиафайлы на Викискладе

История

Изначально MediaTek была подразделением United Microelectronics Corporation (UMC, один из тайваньских производителей микросхем) и разрабатывала чипы для домашних развлекательных продуктов^[5]. 28 мая 1997 года была выведена из состава UMC.

23 июля 2001 года вышла на Тайваньскую фондовую биржу под номером «2454»^{[6][7]}.

В 2004 году было создано подразделение по разработке чипсетов для мобильных телефонов, вскоре это направление стало основным для компании. Чипы, разработанные MediaTek, применялись в 700 млн мобильных телефонах 1500 различных моделей, проданных за 2014 год^[8].

По отчёту IC Insights' McClean Report за май 2009 года, MediaTek стала одной из 20 крупнейших полупроводниковых компаний в мире (по объёму продаж)^[9].

В 2011 году компания MediaTek поглотила Ralink Technology Corporation, специализировавшейся на производстве оборудования для проводных и беспроводных локальных сетей^[10]. В следующем году была куплена шведская компания Coresonic^[11].

22 июня 2012 года было объявлено о начале поглощения компании Mstar Semiconductor, Inc. Сделка была отложена из-за нарушения антимонопольного законодательства Китая и Южной Кореи и завершена только 1 февраля 2014 года^[12]. По результатам 2013 года MediaTek была 4-м крупнейшим разработчиком микросхем в мире (объём продаж 4,59 млрд долл.), а MStar — 13-м (\$1,14 млрд)^[13].

В 2020 году MediaTek стала лидером на рынке мобильных чипов, обогнав Qualcomm: её доля составила 27,2 % (против 17,2 % в 2019 году), а поставки в штучном выражении достигли 351,8 млн единиц (238,0 млн в 2019 году). По итогам 2021 года компания может занять первое место в списке ведущих поставщиков процессоров для смартфонов (укреплению позиций MediaTek может способствовать общий дефицит полупроводниковой продукции), в январе-феврале продажи компании уже выросли на 78 %; столь значительное увеличение отгрузок объясняется восстановлением рынка после удара коронавируса, а также стремительным развитием сегмента 5G^[14].

MediaTek продолжает активно развивать семейство чипов *Dimensity* для устройств с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G); так, в 2022 г. был создан 4-нм процессор Dimensity 9200 с суперсовременным восьмиядерным ядром Cortex X3, модулем Wi-Fi 7 и видеускорителем Immortalis-G715 с технологией трассировки лучей (всего этого нет ни в одном другом подобном процессоре в мире)^[15].

Деятельность

MediaTek является крупнейшим тайваньским проектировщиком микроэлектронных чипов для беспроводной связи и цифровых мультимедиа устройств^[16]. Разрабатывает системы на кристалле для устройств связи, цифрового телевидения, HDTV, DVD, GPS^{[7][17]}, Blu-ray.

MediaTek стала четвёртой среди крупнейших бесфабричных компаний, разрабатывающих микросхемы, в мире (первые три — Qualcomm, Broadcom, AMD) и второй — среди компаний - разработчиков чипсетов^[уточнить] для мобильных телефонов^{[18][19]} (после Qualcomm)^[20].

MediaTek — крупнейший производитель мобильных процессоров в мире (по итогам II квартала 2022 г. доля рынка компании составила 39 %, против 29 % у Qualcomm и 14 % у Apple; статистика Counterpoint Research)^[21]. MediaTek является крупнейшим поставщиком чипов для китайских смартфонов (более половины рынка, на начало 2021 г.).

25 июля 2022 года Intel и MediaTek объявили о стратегическом партнёрстве по производству чипов. MediaTek планирует на технологических мощностях Intel Foundry Services производство чипов для различных интеллектуальных периферийных устройств^{[22][23]}. Принятое решение передать часть заказов на производство процессоров американским компаниям Intel и GlobalFoundries относится к заказам на выпуск не самых передовых микросхем для роутеров и смарт-ТВ, тогда как топовые чипы для неё продолжит выпускать тайваньская TSMC. Цель такой диверсификации — в снижении зависимости от Тайваня, полупроводниковое производство которого может пострадать от продолжающейся торговой войны между США и Китаем^[21].

В апреле 2023 года MediaTek анонсировала новую для себя категорию чипсетов — Dimensity Auto для «умных» автомобилей^[24].



MediaTek MT1389, чипсет для DVD-проигрывателей

В августе 2023 года компания объявила о сотрудничестве с Meta в области внедрения ИИ в процессоры для мобильных устройств^[25].

Продукция

MT62XX

Процессоры данной серии выпускались для сотовых телефонов с 2003 по 2014 год.

Название	CPU (ISA)	fab	CPU	CPU cache	GPU	Memory technology	Wireless radio technologies	Released
MT6205	ARM7 (ARMv5)						GSM	2003
MT6216					No GPU		GSM/GPRS Class 12 MODEM	
MT6217					No GPU		GSM/GPRS Class 12 MODEM	2005
MT6218B		Up to 52 MHz	16 KB Instruction-Cache, 16 KB Data-Cache	No GPU	8-bit or 16-bit up to 64 MB	GSM/GPRS Class 12 MODEM	2003	
MT6219		Up to 52 MHz	16 KB Instruction-Cache, 16 KB Data-Cache	No GPU	8-bit or 16-bit up to 64 MB	GSM/GPRS Class 12 MODEM	2003	
MT6223		Up to 52 MHz	16 KB Instruction-Cache, 16 KB Data-Cache	No GPU	8-bit or 16-bit up to 64 MB	GSM/GPRS Class 12 MODEM	2003	
MT6225				No GPU		GSM/GPRS Class 12 MODEM	2006	
MT6226		Up to 52 MHz	16 KB Instruction-Cache, 16 KB Data-Cache	No GPU	8-bit or 16-bit up to 64 MB	GSM/GPRS Class 12 MODEM	2003	
MT6227		Up to 52 MHz	16 KB Instruction-Cache, 16 KB Data-Cache	No GPU	8-bit or 16-bit up to 64 MB	GSM/GPRS Class 12 MODEM	2003	
MT6228		Up to 52 MHz	16 KB Instruction-Cache, 16 KB Data-Cache	No GPU	8-bit or 16-bit up to 64 MB	GSM/GPRS Class 12 MODEM	2003	
MT6229		Up to 52 MHz	16 KB Instruction-Cache, 16 KB Data-Cache	No GPU	8-bit or 16-bit up to 64 MB	GSM/GPRS Class 12 MODEM	2003	
MT6230		Up to 52 MHz	16 KB Instruction-Cache, 16 KB Data-Cache	No GPU	8-bit or 16-bit up to 64 MB	GSM/GPRS Class 12 MODEM	2003	
MT6235		ARM9 (ARMv5)	Up to 208 MHz		No GPU	8-bit or 16-bit up to 128 MB	GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth	2007
MT6236	Up to 208 MHz			No GPU	8-bit or 16-bit up to 128 MB	GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth	2007	
MT6250	Up to 260 MHz			No GPU		GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth	2012	
MT6252	Up to 104 MHz			No GPU		GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth	2011	
MT6253	Up to 104 MHz			No GPU		GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth	2009	
MT6255				No GPU		GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth		

MT6260	ARM7 (ARMv6)	Up to 364 MHz	No GPU	GSM/GPRS/EDGE/FM, Class 12 MODEM, Bluetooth	2013
MT6261		Up to 260 MHz	No GPU	GSM/GPRS/EDGE/FM, Class 12 MODEM, Bluetooth	2014

MT65XX — 32-битные чипсеты для смартфонов

Процессоры MediaTek позволили создать смартфоны в низком ценовом диапазоне, имеющие хорошую производительность. Компания не просто производит средние по производительности и доступные чипсеты для смартфонов, но также сама совершает инновации в данной области: так, в 2013 году MT6592 становится первым 8-ядерным мобильным чипсетом, а в 2015 году был представлен первый мобильный 10-ядерный чипсет MediaTek Helio X20 (MT6797).

Название	Тех. процесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	GPU	GFlops	Периферия	Анонс
MT6513 (MT6573 без 3G)	65 нм	ARMv6	1 ядро ARM11 650 МГц (ARMv6)	PowerVR SGX 531	2,25	Камера 3 Мп, видео 848x480, дисплей 848x480, GPS, 2 SIM	2011
MT6515 (MT6575 без 3G)	40 нм	ARMv7	1 ядро Cortex-A9 1 ГГц (ARMv7)	PowerVR SGX 531	4,2	Камера 8 Мп, видео 720р, дисплей 960x540	2012
MT6516	65 нм	ARMv5	1 ядро ARM9 416 МГц (ARMv5)	CEVA DSP 312 МГц		Камера 2 Мп, 2 SIM, дисплей до 800x480	2009
MT6517 (MT6577 без 3G)	40 нм	ARMv7	2 ядра Cortex-A9 1,0 ГГц	PowerVR SGX 531 МГц	4,2	Камера 8 Мп, видео 720р, дисплей 1280x720, 802.11n Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM	2012 ^[26]
MT6572	28 нм	ARMv7	2 ядра Cortex-A7 1,2 ГГц	Mali-400MP1 500 МГц	4,5	Камера 5 Мп, видео 720р, дисплей 960x540, 802.11n Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM, HSPA, TDSCDMA	2013 ^[27]
MT6573	65 нм	ARMv6	1 ядро ARM11 650 МГц	PowerVR SGX 531 281 МГц	2,25	Камера 3 Мп, видео 848x480, дисплей 848x480, HSPA, 2SIM, 3G, GPS	2010 ^[28]
MT6575	40 нм	ARMv7	1 ядро Cortex-A9 1 ГГц	PowerVR SGX 531 281 МГц	4,2	Камера 8 Мп, видео 720р, дисплей 960x540, GPS	2011
MT6577	40 нм	ARMv7	2 ядра Cortex-A9 1 ГГц	PowerVR SGX 531 281 МГц	4,2	Камера 8 Мп, видео 720р, дисплей 1280x720, 802.11n Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM, HSPA	2012
MT6577T	40 нм	ARMv7	2 ядра Cortex-A9 1,2 ГГц	PowerVR SGX 531 Ultra	4,2	Камера 8 Мп, видео 720р, дисплей 1280x720, 802.11n Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM, HSPA, HSDPA	2012
MT6589	28 нм	ARM v7	4 ядра Cortex-A7 1,2 ГГц	PowerVR SGX 544 286 МГц	9,2	Камера 13 Мп, видео 1080р, дисплей 1080р, 802.11n Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM, HSPA, TDSCDMA	2013 ^[29]
MT6589T	28 нм	ARMv7	4 ядра Cortex-A7 1,5 ГГц	PowerVR SGX 544 357 МГц	11,4	Камера 13 Мп, видео 1080р, дисплей 1080р, 802.11n Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM, HSPA, TDSCDMA	2013
MT6589M	28 нм	ARMv7	4 ядра Cortex-A7 1,2 ГГц	PowerVR SGX 544 156 МГц	5	Камера 8 Мп, видео 720р, дисплей 960x540, 802.11n Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM, HSPA, TDSCDMA	2013
MT6582	28 нм	ARMv7	4 ядра Cortex-A7 1,3 ГГц	Mali-400MP2 400 МГц	9,0	Камера 13 Мп, видео 1080р, дисплей 720р, 802.11n Wi-Fi, BT 4.0, GPS, GLONASS, FM, HSPA, TDSCDMA ^[30]	2013
MT6582M	28 нм	ARMv7	4 ядра Cortex-A7 1,3 ГГц	Mali-400MP2 400 МГц	14,5	Камера 5 Мп, дисплей 540 x 960, 802.11n Wi-Fi, BT 4.0, GPS, GLONASS, FM, HSPA, TDSCDMA	2013
MT6580 (6582+ модем)	28 нм	ARMv7	4 ядра Cortex-A7 1,3 ГГц	Mali-400MP 400 МГц	9,0	Камера 8 Мп, видео 1080р, дисплей 720р, 802.11n Wi-Fi, BT 4.0, GPS, GLONASS, FM, HSPA, TDSCDMA ^[30]	2015
MT6588M	28 нм	ARMv7	4 ядра Cortex-A7 1,7 ГГц	Mali-450MP4 600 МГц	35,8	Камера 13 Мп, видео 1080р, дисплей 1920x1080, Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM, HSPA, TDSCDMA	2014
MT6591M	28 нм	ARMv7	6 ядер Cortex-A7 1,5 ГГц	Mali-450MP4 600 МГц	35,8	Камера xx Мп, видео 1080р, Дисплей 1920x1080 Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM, HSPA, TDSCDMA	2014

Название	Тех. процесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	GPU	GFlops	Периферия	Анонс
MT6592M/W/T	28 нм	ARMv7	8 ядер Cortex-A7 M: 1,4 ГГц W: 1,7 ГГц T: 2 ГГц ^[31]	Mali-450MP4 ^{[32][33]} 700 МГц	35,8	Камера 16 Мп, видео 2160р, дисплей 1080р, Wi-Fi, FM, Bluetooth, GPS ^[34]	2013
MT6595 ^[35]	28 нм	ARMv7	4 ядра Cortex-A17 2,2 ГГц 4 ядра Cortex-A7 1,5 ГГц	PowerVR Rogue G6200 600 (450) МГц	76,8	Камера 20 Мп, видео 4К (2К), дисплей WQXGA (FHD), Wi-Fi 802.11ac, LTE, HSPA, Bluetooth LE, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, ANT+	2014

MT67XX — 64-битные процессоры для смартфонов начального и среднего уровня

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
MT6732	28 нм	ARMv8	4 ядра Cortex-A53 1,5 ГГц	Mali-T760 MP2 650 MHz	LPDDR3 800 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 13 Мп	2014
MT6732M	28 нм	ARMv8	4 ядра Cortex-A53 1,3 ГГц	Mali-T760 MP2 500 MHz	LPDDR3 800 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 13 Мп	3кв. 2014
MT6735	28 нм	ARMv8	4 ядра Cortex-A53 1,3 ГГц	Mali-T720 650 MHz	LPDDR3 800 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 13 Мп	2кв. 2015
MT6735M	28 нм	ARMv8	4 ядра Cortex-A53 1,3 ГГц	Mali-T720 600 MHz	LPDDR3 800 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 13 Мп	2кв. 2015
MT6735P	28 нм	ARMv8	4 ядра Cortex-A53 1 ГГц	Mali-T720 600 MHz	LPDDR3 800 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 13 Мп	3кв. 2015
MT6737	28 нм	ARMv8-A	4 ядра Cortex-A53 1,3 ГГц	ARM Mali-T720 MP2 550 МГц	LPDDR3 640 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720	2кв. 2016

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
						пикселей Поддержка одиночной камеры до 13 Мп	
MT6737M	28 нм	ARMv8-A	4 ядра Cortex-A53 1,1 ГГц	ARM Mali-T720 MP2 550 МГц	LPDDR3 640 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 13 Мп	2кв. 2016
MT6737T	28 нм	ARMv8-A	4 ядра Cortex-A53 1,5 ГГц	ARM Mali-T720 MP2 600 МГц	LPDDR3 733 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до FullHD 1920x1080 пикселей Поддержка одиночной камеры до 13 Мп	2кв. 2016
MT6738	28 нм	ARMv8-A	4 ядра Cortex-A53 1,5 ГГц	ARM Mali-T860 MP2 350 МГц	LPDDR3 667 МГц до 4ГБ	LTE Cat.6 скачивание до 300Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 13МП	4кв. 2016
MT6738T	28 нм	ARMv8-A	4 ядра Cortex-A53 1,5 ГГц	ARM Mali-T860 MP2 520 МГц	LPDDR3 667 МГц	LTE Cat.6 скачивание до 300Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 13МП	4кв. 2016
MT6739	28 нм	ARMv8-A	4 ядра Cortex-A53 1,5 ГГц	PowerVR GE8100 570 МГц	LPDDR3 667 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD+ 1440x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 13 Мп	4кв. 2017
MT6750	28 нм	ARMv8-A	Восьмиядерный 4 ядра Cortex-A53 1500 МГц 4 ядра Cortex-A53 1000 МГц	ARM Mali -T860 MP2 520 МГц	LPDDR3 667 МГц	LTE Cat.6 скачивание до 300Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 24МП	2кв. 2016
MT6750T	28 нм	ARMv8-A	Восьмиядерный 4 ядра Cortex-A53 1500 МГц 4 ядра Cortex-A53 1000 МГц	ARM Mali-T860 MP2 650 МГц	LPDDR3 933 МГц	LTE Cat.6 скачивание до 300Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до HD 1280x720 пикселей Поддержка одиночной камеры до 24МП	2кв. 2016
MT6752	28 нм	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 1,7 ГГц	ARM Mali-T760 MP2 700 МГц	LPDDR3 800 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до FullHD 1920x1080 пикселей Поддержка одиночной камеры до 16МП	4кв. 2014
MT6752M	28 нм	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 1,5 ГГц	ARM Mali-T760 MP2 700 МГц	LPDDR3 800 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с	4кв. 2014

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
						Поддержка дисплеев до FullHD 1920x1080 пикселей Поддержка одиночной камеры до 16МП	
MT6753	28 нм	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 1,3 ГГц	Mali T720 MP3 700 МГц	LPDDR3 800 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до FullHD 1920x1080 пикселей Поддержка одиночной камеры до 16МП	2кв. 2015
MT6753T	28 нм	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 1,5 ГГц	Mali T720 MP4 700 МГц	LPDDR3 800 МГц	LTE Cat.4 скачивание до 150Мбит/с, загрузка до 50Мбит/с Поддержка дисплеев до FullHD 1920x1080 пикселей Поддержка одиночной камеры до 16МП	4кв. 2015

Helio A — линейка бюджетных процессоров для смартфонов

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
Helio A20 (MT6761D)	12 нм FinFET TSMC	ARMv8-A	4 ядра Cortex-A53 до 1.8 ГГц	PowerVR GE8300 до 550 МГц	до 4 ГБ LPDDR3 800MHz LPDDR4 1200 МГц	Поддержка памяти eMMC 5.1 LTE Cat.6 до 300 Мбит/с Поддержка двойной камеры до 13МП+5МП или одиночной до 16МП Поддержка дисплеев HD+ до 1600x720 пикселей Технологии CorePilot, NeuroPilot, Tiny Sensor Hub	3кв. 2020
Helio A22 (MT6761)	12 нм FinFET TSMC	ARMv8-A	4 ядра Cortex-A53 до 2.0 ГГц	PowerVR GE8320 до 650 МГц	до 4 ГБ LPDDR3 933 MHz до 6 ГБ LPDDR4X 1600 MHz	Поддержка памяти eMMC 5.1 LTE Cat.7 до 300 Мбит/с на скачивание и LTE Cat.13 до 150 Мбит/с на загрузку Поддержка двойной камеры до 13МП+8МП или одиночной до 21МП Поддержка дисплеев HD+ до 1600x720 пикселей Технологии NeuroPilot, CorePilot 4.0, Imagiq, MiraVision	2кв. 2018
Helio A25 MT6762D	12 нм FinFET TSMC	ARMv8-A	4 ядер Cortex-A53 до 1.8 ГГц 4 ядер Cortex-A53 до 1.5 ГГц	PowerVR GE8320 до 600 МГц	до 4 ГБ LPDDR3 933MHz LPDDR4 1200 МГц LPDDR4X 1600 МГц	Поддержка памяти eMMC 5.1 LTE Cat.4 до 150 Мбит/с Поддержка двойной камеры до 13МП+5МП или одиночной до 16МП Поддержка дисплеев HD+ до 1600x720 пикселей Технологии CorePilot, Imagiq,	1кв. 2020

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
						MiraVision, NeuroPilot, Pump Express, Tiny Sensor Hub	

Helio P — линейка процессоров для смартфонов среднего класса

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
Helio P10 (MT6755)	28 нм	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 до 2,0 ГГц	Mali T860 MP2 700 МГц	LPDDR3 933 МГц	Камера 21 Мп Дисплей Full HD (1920x1080) LTE Cat. 6	4кв. 2015
Helio P15 (MT6755 Pro)	28 нм	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 до 2,2 ГГц	Mali T860 MP2 800 МГц	LPDDR3 933 МГц	LTE Cat. 6	4кв. 2016
Helio P20 (MT6757)	16 нм TSMC	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 до 2,3 ГГц	Mali T880 MP2 900 МГц	LPDDR4x 1600 МГц	LTE Cat. 6	4кв. 2016
Helio P22 (MT6762)	12 нм FinFET TSMC	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 до 2,0 ГГц	PowerVR GE8320 650МГц	до 4ГБ LPDDR3 933 МГц или до 6ГБ LPDDR4x 1600 МГц	LTE Cat.7/Cat.13 — до 300Мбит/с на скачивание и до 150Мбит/с на загрузку Поддержка двойной камеры до 13МП+8МП или одиночной до 21МП Поддержка дисплеев HD+ до 1600x720 пикселей Технологии Core Pilot 4.0, EnergySmart Screen, Imagiq, Miravision	2кв. 2018
Helio P23 (MT6763T)	16 нм FinFET Compact	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 до 2,3 ГГц	Mali-G71 MP2 770 МГц	LPDDR4x 1500 МГц до 6ГБ LPDDR3 933МГц до 4ГБ	LTE Cat.7/Cat.13 — до 300 Мбит/с на скачивание и до 150 Мбит/с на загрузку Поддержка двойной камеры до 13МП+13МП или одиночной до 24МП Поддержка дисплеев до FullHD+ 2160x1080 пикселей Core Pilot 4.0, EnergySmart Screen, Imagiq, Miravision	1кв. 2017
Helio P25 (MT6757 Pro)	16 нм	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 до 2,5 ГГц	Mali T880 MP2 900 МГц	LPDDR4x 1600 МГц	LTE Cat. 6	4кв. 2016
Helio P30 ^[36] (MT6759)	16 нм FinFET Compact	ARMv8-A	Восьмиядерный 4 ядра Cortex-A53 до 2,3ГГц	Mali-G71 MP2 950 МГц	LPDDR4x 1600 МГц до 6ГБ ОЗУ	Поддержка памяти eMMC 5.1 и UFS 2.1 LTE Cat.7/Cat.13 — до 300 Мбит/с на скачивание и до 150 Мбит/с на	1кв. 2017

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
			4 ядра Cortex-A53 до 1.65ГГц			загрузку Поддержка двойной камеры до 16МП+16МП, одиночной до 25МП, видео 4K Поддержка экранов до FullHD+ 2160x1080 пикселей Core Pilot 4.0, EnergySmart Screen, Imaqiq, Miravision	
Helio P35 ^[37] (MT6765)	12 нм FinFET TSMC	ARM Cortex-A53	4 ядра Cortex-A53 2.3 ГГц 4 ядра Cortex-A53 1.8 ГГц	IMG PowerVR GE8320 680MHz	LPDDR3, LPDDR4x 933MHz; 1600MHz	LTE Category: Cat-4, Cat-7 DL / Cat-13 UL	3кв. 2017
Helio P40	12 нм TSMC	ARMv8-A	Восьмиядерный 4 ядра Cortex-A73 до 2,0 ГГц 4 ядра Cortex-A53 до 2,0 ГГц	Mali-G71 MP3 700МГц	LPDDR4x 1866 МГц до 8ГБ ОЗУ	Поддержка памяти eMMC 5.1 и UFS 2.1 LTE Cat.7 до 300Мбит/с на скачивание и до 100Мбит/с на загрузку 3xISP, поддержка камеры до 32МП DSP, поддержка технологий машинного обучения Caffe 1/2 и TensorFlow	2кв. 2018
Helio P60 (MT6771)	12 нм FinFET TSMC	ARMv8-A	Восьмиядерный 4 ядра Cortex-A73 до 2,0 ГГц 4 ядра Cortex-A53 до 2,0 ГГц	Mali-G72 MP3 800 МГц	до 4ГБ LPDDR3 933МГц или до 8 ГБ LPDDR4x 1800 МГц	Поддержка памяти eMMC 5.1 и UFS 2.1 LTE Cat.7 до 300 Мбит/с на скачивание и LTE Cat.13 до 150 Мбит/с на загрузку 3xISP, поддержка одиночной камеры до 32МП или двойной до 24МП+16МП AI технологии камеры	2кв. 2018
Helio P70 ^[38] (MT6769)	12 нм FinFET TSMC	ARMv8-A	Восьмиядерный 4 ядра Cortex-A73 до 2,5 ГГц 4 ядра Cortex-A53 до 2,0 ГГц	Mali-G72 MP3 900МГц	LPDDR4x 1866 МГц до 8ГБ ОЗУ	Поддержка памяти eMMC 5.1 и UFS 2.1 LTE Cat.12 скорость скачивания до 600 Мбит/с, загрузки — до 150 Мбит/с 3xISP, поддержка камеры до 32МП DSP, поддержка технологий машинного обучения Caffe 1/2 и TensorFlow	2кв. 2018
Helio P90 (MT6779)	12 нм FinFET TSMC	ARMv8-A	Восьмиядерный 2 ядра Cortex-A75 до 2,2 ГГц 6 ядер Cortex-A55 до 2,0 ГГц	PowerVR GM9446 900МГц	LPDDR4x 1866МГц до 8ГБ ОЗУ	Поддержка памяти UFS 2.1 LTE Cat.12 скорость скачивания до 600 Мбит/с, загрузки — до 150 Мбит/с Поддержка двойной камеры до 24МП+16МП или одиночной до	4кв. 2018

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
						48МП Поддержка дисплеев FullHD+ до 2520x1080 пикселей Технологии NeuroPilot, CorePilot 4.0, Imagiq, MiraVision	

Helio X — линейка производительных процессоров для смартфонов

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
Helio X10 MT6795	28 нм	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 2 ГГц	PowerVR G6200 700 МГц	LPDDR3 933 МГц	Сеть: LTE Cat.4	2 кв. 2015
Helio X10T MT6795	28 нм	ARMv8-A	8 ядер Cortex-A53 2,2 ГГц	PowerVR G6200 700 МГц	LPDDR3 933 МГц	поддержка записи и проигрывания H.265 Ultra HD, H.264 & VP9, LTE: Rel. 9, Cat. 4 FDD/TDD(150 Mbps/50 Mbps), Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth®/FM/GPS/Glonass/Beidou/ANT+, Hi-Fidelity audio, achieving 110 dB SNR & 90 dB THD, поддержка 120 Hz дисплеев с Response Time Enhancement Technology и MediaTek ClearMotion™, первая в мире технология съёмки видео 480 fps 1080p Full HD (называется Super-Slow Motion) — то есть с 16-кратным замедлением, поддержка multimode-беспроводной зарядки — Qi, PMA и Rezence.	2 кв. 2015
Helio X20 MT6797	20 нм HPM	ARMv8-A	Десятиядерный 2 ядра Cortex-A72 2,1 ГГц 4 ядра Cortex-A53 1,85 ГГц 4 ядра Cortex-A53 1,4 ГГц	Mali-T880 MP4 780 МГц	LPDDR3 933 МГц	Поддержка камер до 25 Мп (dual ISP), супер замедление, фазовый автофокус (PDAF) Native3D 2.0 для 3D съёмки Поддержка 4K HDR видео Поддержка дисплеев с разрешением WQXGA (2560x1600) Поддержка всех основных современных мобильных стандартов, включая LTE FDD/TDD R11 Cat 6 с 20+20 CA и CDMA2000 Wi-Fi 802.11ac, GPS/Glonass/Beidou, TTFF & Drift, BT/FM Быстрая зарядка PumpExpress+ 3.0, Vulkan API	4 кв. 2015
Helio X23 MT6797D	20 нм HPM	ARMv8-A	Десятиядерный 2 ядра Cortex-A72 2,3 ГГц 4 ядра Cortex-A53 1,85 ГГц 4 ядра Cortex-A53 1,4 ГГц	Mali-T880 MP4 780 МГц	LPDDR3 933 МГц	Поддержка камеры до 32 Мп или двойной камеры 13 МП + 13 МП, Dual ISP Сеть: LTE Cat.6	1 кв. 2017
Helio X25 MT6797T	20 нм HPM	ARMv8-A	Десятиядерный 2 ядра Cortex-A72 2,5 ГГц 4 ядра Cortex-A53 2ГГц	Mali-T880 MP4 850 МГц	LPDDR3 933 МГц	Поддержка камер до 25 Мп (dual ISP), супер замедление, фазовый автофокус (PDAF) Native3D 2.0 для 3D съёмки	2 кв. 2016

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
			4 ядра Cortex-A53 1,55 ГГц			Поддержка 4K HDR видео Поддержка дисплеев с разрешением WQXGA (2560x1600) Поддержка всех основных современных мобильных стандартов, включая LTE FDD/TDD R11 Cat 6 с 20+20 CA и CDMA2000 Wi-Fi 802.11ac, GPS/Glonass/Beidou, TTFF & Drift, BT/FM Быстрая зарядка PumpExpress+ 3.0, Vulkan API	
Helio X27 MT6797X ^[39]	20 нм HPM	ARMv8-A	Десятиядерный 2 Cortex-A72 2,6 ГГц 4 Cortex-A53 2 ГГц 4 Cortex-A53 1,6 ГГц	Mali-T880 MP4 875 МГц	LPDDR3 933 МГц	Поддержка камеры до 32 Мп или двойной камеры 13 МП + 13 МП, Dual ISP Сеть: LTE Cat.6	1 кв. 2017
Helio X30 MT6799	10 нм FinFET+	ARMv8-A	Десятиядерный 2 ядра Cortex-A73 2,5 ГГц 4 ядра Cortex-A53 2,2 ГГц 4 ядра Cortex-A35 1,9 ГГц	PowerVR 7400XT MP4 800 МГц	LPDDR4X 1866 МГц	UFS 2.1 Камеры до 28 Мп (с двумя ISP с Imagiq 2.0) Макс. разрешение записи видео: 4K 3840×2160 Дисплей с разрешением до 2560x1600 точек LTE Cat. 10 с агрегацией частот 3CA Hi-Fi & 4-Mic ANC Audio Codec CorePilot 4.0	1 кв. 2017
Helio X35 MT6799T	10 нм FinFET+	ARMv8-A	Десятиядерный 2 ядра Cortex-A73 3 ГГц 4 ядра Cortex-A53 2,2 ГГц 4 ядра Cortex-A35 2 ГГц	PowerVR 7400XT MP4 800МГц	LPDDR4X 1866 МГц	LTE Cat.12	2 кв. 2017

В 2017 году MediaTek заявляет о прекращении работы над линейкой Helio X и переключении внимания на линейку Helio P.

Helio G — чипсеты для мобильных телефонов с уклоном на игровую составляющую

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
Helio G25 MT6762G	12 нм FinFET+	ARMv8-A	Восьмиядерный 8x Cortex-A53 2 ГГц	PowerVR GE8320 680МГц	До 4/6 Гб LPDDR3/4X 933МГц/1.6МГц	Поддержка камер с разрешением 21 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 60 Гц; Поддержка NFC модуля; Поддержка LTE (Cat. 7)	3 кв. 2020
Helio G35 MT6765G	12 нм FinFET+	ARMv8-A	Восьмиядерный 8x Cortex-A53 2.3 ГГц	PowerVR GE8320 680МГц	До 4/6 Гб LPDDR3/4X 933МГц/1.6МГц	Поддержка камер с разрешением 25 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 60 Гц; Поддержка NFC модуля; Поддержка LTE (Cat. 7)	3 кв. 2020
Helio G37	12 нм FinFET+	ARMv8.2-A	Восьмиядерный 4x Cortex-A53 2.3 ГГц; 4x Cortex-A53 1.8 ГГц	PowerVR GE8320 680МГц	До 4/6 Гб LPDDR3/4X 933МГц/1.6МГц	Поддержка камер с разрешением 25 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 60 Гц; Поддержка NFC модуля; Поддержка LTE (Cat. 7)	3 кв. 2020

Helio G70 MT6769V/CB	12 нм FinFET+	ARMv8-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A75 2 ГГц; 6x Cortex-A55 1.7 ГГц.	Mali-G52MC2 820МГц	До 8 Гб LPDDR4X 1.8МГц	Поддержка камер с разрешением 48 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 60 Гц; Поддержка NFC модуля; Поддержка быстрой зарядки <u>Quick Charge 4</u> Поддержка LTE (Cat. 7)	1 кв. 2020
Helio G80/G85 MT6769T/MT6769Z	12 нм FinFET+	ARMv8-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A75 2 ГГц; 6x Cortex-A55 1.8 ГГц.	Mali-G52MC2 950МГц/1ГГц	До 8 Гб LPDDR4X 1.8МГц	Поддержка камер с разрешением 48 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 60 Гц; Поддержка NFC модуля; Поддержка быстрой зарядки <u>Quick Charge 4</u> Поддержка LTE (Cat. 7)	1/2 кв. 2020
Helio G88 MT6769H	12 нм FFC	ARMv8.2-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A75 2 ГГц; 6x Cortex-A55 1.8 ГГц.	Mali-G52MC2 950МГц/1ГГц	До 8 Гб LPDDR4X 1.8МГц	Поддержка камер с разрешением 1x64мп и 2x16 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 90 Гц; Поддержка NFC модуля; Поддержка быстрой зарядки <u>Quick Charge 4</u>	4 кв. 2021

						Поддержка LTE (Cat. 7)	
Helio G90 MT6785	12 нм FinFET+	ARMv8-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A76 2,05 ГГц; 6x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G76MC4 720МГц	До 10 Гб LPDDR4X 2133МГц	Поддержка камер с разрешением 64 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 90 Гц; Поддержка NFC модуля; Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+ Поддержка LTE (Cat. 12)	3 кв. 2019
Helio G90T MT6785V/CC	12 нм FinFET+	ARMv8-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A76 2 ГГц; 6x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G76MC4 800МГц	До 10 Гб LPDDR4X 2133МГц	Поддержка камер с разрешением 64 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 90 Гц; Поддержка NFC модуля; Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+ Поддержка LTE (Cat. 12)	3 кв. 2019
Helio G95 MT6785V/CD	12 нм	ARMv8.2-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A76 2,05 ГГц; 6x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G76MC4 900МГц	До 10 Гб LPDDR4X 2133МГц	Поддержка камер с разрешением 64 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 90 Гц; Поддержка NFC модуля; Поддержка LTE (Cat. 12)	Сентябрь 2020

Helio G96	12 нм	ARMv8.2-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A76 2.05 ГГц; 6x Cortex-A55 2ГГц.	Mali G57 MC2 850 МГц	До 10 Гб LPDDR4X 2133МГц	Поддержка камер с разрешением 108 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 120 Гц; Поддержка LTE (Cat. 13); Поддержка NFC модуля; Поддержка съемки 4K со скоростью 30 кадров в секунду; Поддержка памяти USF 2.2; Поддержка Wi-Fi 5; Поддержка Bluetooth 5.2.	Июнь 2021
Helio G99 MT6789V	6 нм	ARMv8.2-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A76 2.2 ГГц; 6x Cortex-A55 2ГГц.	Mali G57 MC2 850 МГц	До 10 Гб LPDDR4X 2133МГц	Поддержка камер с разрешением 108 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 120 Гц; Поддержка LTE (Cat. 13); Поддержка NFC модуля; Поддержка съемки 4K со скоростью 30 кадров в секунду; Поддержка памяти USF 2.2; Поддержка Wi-Fi 5; Поддержка Bluetooth 5.2.	Май 2022

Dimensity — чипсеты для телефонов со встроенным 5G-модемом^[40]

Название	Техпроцесс	Набор инструкций	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Память RAM	Периферия	Анонс
Dimensity 700 MT6833V/ZA	7 нм	ARMv8.2-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A76 2,2 ГГц 6x Cortex-A55 2 ГГц	Mali-G57 MC2	До 12 Гб LPDDR4X	Поддержка камер с разрешением до 64 мегапикселей; Поддержка дисплеев с частотой обновления 90 Гц	4 кв. 2020
Dimensity 720 MT6853V/ZA		ARMv8.2-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A76 2 ГГц 6x Cortex-A55 2 ГГц	Mali-G57 MC3	До 12 Гб LPDDR4X	Поддержка камер с разрешением до 64 мегапикселей; Поддержка дисплеев с частотой обновления 90 Гц	3 кв. 2020
Dimensity 800 MT6873		ARMv8-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A76 2 ГГц; 6x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G57 MC4	До 16 Гб LPDDR4X	Поддержка камер с разрешением до 64 мегапикселей	4 кв. 2019
Dimensity 800U MT6853T		ARMv8-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A76 до 2,4 ГГц; 6x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G57 MC3	До 12 Гб LPDDR4x	Поддержка камер с разрешением 64 Мп; Поддержка дисплеев с частотой обновления 120 Гц	3 кв. 2020
Dimensity 810 MT6874		ARMv8.2-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A76 до 2,4 ГГц; 6x Cortex-A55 до 2 ГГц.	Mali-G57 MC2	До 16 Гб LPDDR4x	Поддержка камер с разрешением 64 Мп; Поддержка дисплеев с частотой обновления 120 Гц	3 кв. 2021
Dimensity 820 MT6875		ARMv8-A	Восьмиядерный 4x Cortex-A76 2.6 ГГц; 4x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G57 MC5	До 16 Гб LPDDR4X	Поддержка камер с разрешением 80 мегапикселей	2 кв. 2020

Dimensity 900 MT6877	6 нм	ARMv8-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A78 2.4 ГГц; 6x Cortex-A55 2 ГГц	Mali-G68 MC4	До 16 ГБ LPDDR4X или LPDDR5	Поддержка камер с разрешением 108МП; Поддержка экранов с частотой развертки 120 Гц	2 кв. 2021
Dimensity 920 MT6877T		ARMv8.2-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A78 2.5 ГГц; 6x Cortex-A55 2 ГГц	Mali-G68 MC4	До 16 ГБ LPDDR4X или LPDDR5	Поддержка камер с разрешением 108МП; Поддержка экранов с частотой развертки 120 Гц	3 кв. 2021
Dimensity 930 MT6878		ARMv8.2-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A78 2.2 ГГц; 6x Cortex-A55 2 ГГц	IMG BXM-8-256	До 16 ГБ LPDDR4X или LPDDR5	Поддержка камер с разрешением 108МП; Поддержка экранов с частотой развертки 120 Гц	2 кв. 2022
Dimensity 1000 MT6889	7 нм	ARMv8.3-A	Восьмиядерный 4x Cortex-A77 2,6 ГГц; 4x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G77 MC9	До 16 Гб LPDDR4X	Поддержка камер с разрешением 80 мегапикселей	4 кв. 2019
Dimensity 1000C MT6883Z/CZA		ARMv8-A	Восьмиядерный 4x Cortex-A77 2 ГГц; 4x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G57 MC5	До 12 ГБ LPDDR4X	Поддержка камер с разрешением 64 мегапикселя	3 кв. 2020
Dimensity 1000L MT6885Z/CZA		ARMv8-A	Восьмиядерный 4x Cortex-A77 2,2 ГГц; 4x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G77 MC9	До 16 Гб LPDDR4X	Поддержка камер с разрешением 80 мегапикселей	4 кв. 2019
Dimensity 1000+ MT6889Z/CZA		ARMv8.3-A	Восьмиядерный 4x Cortex-A77 2,6 ГГц; 4x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G77 MC9	До 16 Гб LPDDR4X	Поддержка камер с разрешением 80 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 144 Гц	2 кв. 2020

Dimensity 1050 MT6879	6 нм	ARMv8.2-A	Восьмиядерный 2x Cortex-A78 2.5 ГГц; 6x Cortex-A55 2 ГГц	Mali-G610 MC3	До 16 ГБ LPDDR4X или LPDDR5	Поддержка камер с разрешением 108МП; Поддержка экранов с частотой развертки 144 Гц	2 кв. 2022
Dimensity 1080 MT6877V/TTZA			Восьмиядерный 2x Cortex-A78 2.6 ГГц; 6x Cortex-A55 2 ГГц	Mali-G68 MC	LPDDR4X или LPDDR5	Поддержка камер с разрешением 200МП; Поддержка экранов с частотой развертки 120 Гц	4 кв. 2022
Dimensity 7050							2 кв. 2023
Dimensity 1100 MT6891Z/CZA			Восьмиядерный 4x Cortex-A78 2,6 ГГц; 4x Cortex-A55 2 ГГц.	Mali-G77 MC9	До 16 Гб LPDDR4X До 4266 МГц	Поддержка камер с разрешением 108 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 144 Гц	1 кв. 2021
Dimensity 1200 MT6893			Восьмиядерный 1x Cortex-A78 3,0 ГГц; 3x Cortex-A78 2,6 ГГц; 4x Cortex-A55 2 ГГц.			Поддержка камер с разрешением 200 мегапикселей; Поддержка экранов с частотой развертки 168 Гц	1 кв. 2021
Dimensity 8050 MT6893Z/TCZA						2 кв. 2023	
Dimensity 8000 MT6895	5 нм	ARMv8.2-A	Восьмиядерный 4x Cortex-A78 2.75GHz; 4x Cortex-A55 2.0GHz	Mali-G610 MC6	До 16 ГБ LPDDR5		1 кв. 2022
Dimensity 8100 MT6895Z/TCZA			Восьмиядерный 4x Cortex-A78 2.85GHz; 4x Cortex-A55 2.0GHz			Поддержка камер с разрешением 200 мегапикселей; Поддержка экранов FullHD+ с частотой развертки 168 Гц; Поддержка экранов WQHD+ с частотой развертки 120 Гц	1 кв. 2022
Dimensity 8200 MT6896Z	4 нм (TSMC N4)	ARMv8.2-A	Восьмиядерный 1x Cortex-A78 3,1 ГГц; 3x Cortex-A78 3,0 ГГц; 4x Cortex-A55 2,0 ГГц.	Mali-G610 MP6	До 16 ГБ LPDDR5	Поддержка камер с разрешением 320 мегапикселей; Поддержка экранов FullHD+ с частотой развертки 180 Гц Поддержка экранов WQHD+ с частотой развертки 144 Гц	4 кв. 2022

Dimensity 9000 MT6983	4 нм (TSMC N4)	ARMv9-A	Восьмиядерный 1x Cortex-X2 3,05 ГГц; 3x Cortex-A710 2,85 ГГц; 4x Cortex-A510 1,8 ГГц.	Mali-G710 MC10	До 16 Гб LPDDR5X	Поддержка камер с разрешением 320 мегапикселей; Поддержка экранов FullHD+ с частотой развертки 180 Гц Поддержка экранов WQHD+ с частотой развертки 144 Гц	4 кв. 2021
Dimensity 9000 Plus MT6983Z			Восьмиядерный 1x Cortex-X2 3,2 ГГц; 3x Cortex-A710 2,85 ГГц; 4x Cortex-A510 1,8 ГГц.		До 24 Гб LPDDR5X		2 кв. 2022
Dimensity 9200 MT6985	4 нм (TSMC N4P)		Восьмиядерный 1x Cortex-X3 3,05 ГГц; 3x Cortex-A715 2,85 ГГц; 4x Cortex-A510 1,8 ГГц.	Mali-G715 MC11 Immortalis	До 24 Гб LPDDR5X	Поддержка камер с разрешением 320 мегапикселей; Поддержка экранов FullHD+ с частотой развертки 240 Гц Поддержка экранов WQHD+ с частотой развертки 144 Гц	4 кв. 2022
Dimensity 9200 Plus			Восьмиядерный 1x Cortex-X3 3,35 ГГц; 3x Cortex-A715 3,0 ГГц; 4x Cortex-A510 2,0 ГГц.				2 кв. 2023

Чипсеты для планшетов

MT81XX

Название	Техпроцесс	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Периферия	Анонс
MT8117	28 нм	2x Cortex-A7 1,2 ГГц	PowerVR SGX544	2G/3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM	2013
MT8121		4x Cortex-A7 1,3 ГГц	PowerVR SGX544	2G/3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM	2013
MT8125		4x Cortex-A7 1,5 ГГц	PowerVR SGX544	2G/3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM	2013
MT8127		4x Cortex-A7 1,5 ГГц	Mali-450 MP4	4G LTE Cat-4, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, FM, 13Mn ISP, FM, H.264 (AVC)	2014
MT8135		2x Cortex-A15 1,7 ГГц 2x Cortex-A7 1,2 ГГц	PowerVR G6200	4G LTE Cat-4, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, FM, 13Mn ISP, FM, H.264 (AVC)	2013
MT8163V/A		4x Cortex-A53 1,5 ГГц	Mali-T720 MP2	4G LTE Cat-4, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, FM, 13Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2014
MT8163V/B		4x Cortex-A53 1,3 ГГц	Mali-T720 MP2	4G LTE Cat-4, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, FM, 13Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2014
MT8167A		4x Cortex-A35 1,5 ГГц	PowerVR GE8300	4G LTE Cat-4, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, FM, 8Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2016
MT8167B		4x Cortex-A35 1,3 ГГц	PowerVR GE8300	4G LTE Cat-4, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, FM, 8Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2016
MT8168		12 нм	4x Cortex-A53 2 ГГц	Mali-G52 MC1	4G LTE Cat-4, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, FM, 13Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP-9
MT8173	28 нм	2x Cortex-A72 2 ГГц 4x Cortex-A53 1,3 ГГц	PowerVR GX6250	4G LTE Cat-4, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, FM, 20Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2015
MT8175	12 нм	4x Cortex-A53 2 ГГц	Mali-G52 MC1	4G LTE Cat-4, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, FM, 13Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP-9	2019
MT8176	28 нм	2x Cortex-A72 2,1 ГГц 4x Cortex-A53 1,7 ГГц	PowerVR GX6250	4G LTE Cat-4, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, FM, 20Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP-9	2016
Kompanio 500 MT8183	12 нм	4x Cortex-A73 2 ГГц 4x Cortex-A53 2 ГГц	Mali-G72 MP3	4G LTE Cat-7 DL/Cat-13 UL, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, FM, 32Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2018
Kompanio 820 MT8192	7 нм	4x Cortex-A76 2,2 ГГц 4x Cortex-A55 2 ГГц	ARM Mali-G57 MC5	4G LTE Cat-7 DL/Cat-13 UL, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, FM, 32Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP-9	2020
Kompanio 900T MT6983VT	6 нм	2x Cortex-A78 2,4 ГГц 6x Cortex-A55 2 ГГц	ARM Mali-G68 MC4	5G, 4G LTE Cat-21 DL/Cat-17 UL, Wi-Fi6 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, FM, 32Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP-9	2021
Kompanio 1300T MT6983		4x Cortex-A78 2,6 ГГц 4x Cortex-A55 2 ГГц	ARM Mali-G77 MC9	5G, 4G LTE Cat-21 DL/Cat-17 UL, Wi-Fi6 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, FM, 32Mn ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP-9	2021

MT83XX

Название	Техпроцесс	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Периферия	Анонс
MT8312	28 нм	2x Cortex-A7 1,3 ГГц	Mali-400	2G/3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM	2014
MT8317	40 нм	2x Cortex-A9 1.0ГГц	PowerVR SGX531	2G/3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM	2013
MT8317T	28 нм	2x Cortex-A9 1.2ГГц	PowerVR SGX531	2G/3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM	2013
MT8321		4x Cortex-A7 1.3ГГц	Mali-400	2G/3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM	2014
MT8377	40 нм	2x Cortex-A9 1 ГГц	PowerVR SGX531	2G/3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM	2013
MT8382	28 нм	4x Cortex-A7 1,3 ГГц	Mali-400 MP2	2G/3G, Wi-Fi 802.11b/g/n , Bluetooth, GPS, FM	2014
MT8389		4x Cortex-A7 1,2 ГГц	PowerVR SGX544	2G/3G, Wi-Fi 802.11b/g/n , Bluetooth, GPS, FM	2014
MT8389T		4x Cortex-A7 1.5 ГГц	PowerVR SGX544	2G/3G, Wi-Fi 802.11b/g/n , Bluetooth, GPS, FM	2014
MT8392		8x Cortex-A7 1,7 ГГц	Mali-450 MP4	2G/3G, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth, GPS, FM	2014

MT87XX

Название	Техпроцесс	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Периферия	Анонс
MT8732	28 нм	4x Cortex-A53 1,5 ГГц	Mali-760 MP2	4G LTE Cat-4, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 13Мп ISP, H.264 (AVC)	2014
MT8735B		4x Cortex-A53 1,1 ГГц	Mali-T720	4G LTE Cat-4, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 13Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), экран 1280x800	2015
MT8735D		4x Cortex-A53 1,1 ГГц	Mali-T720	4G LTE Cat-4, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 13Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), экран 1280x800	2015
MT8735M		4x Cortex-A53 1 ГГц	Mali-T720	4G LTE Cat-4, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 8Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), экран 1024x600	2015
MT8735P		4x Cortex-A53 1 ГГц	Mali-T720	4G LTE Cat-4, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 8Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), экран 1920x1080	2015
MT8752		8x Cortex-A53 1,7 ГГц	Mali-T760 MP2	4G LTE Cat-4, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 13Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2014
MT8766B		4 x Cortex-A53 2 ГГц	PowerVR GE8300	4G LTE Cat-4 DL/Cat-5 UL, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n/ac, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 21Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2019
MT8768T (P22T)		4x Cortex-A53 2,3 ГГц 4x Cortex-A53 1,8 ГГц	PowerVR GE8320	4G LTE Cat-7 DL/Cat-13 UL, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n/ac, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 25Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2020
MT8783		8x Cortex-A53 1,3 ГГц	Mali-T720	4G LTE Cat-4, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 25Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2015
MT8783T		8x Cortex-A53 1,5 ГГц	Mali-T720	4G LTE Cat-4, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 25Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2015

Название	Техпроцесс	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Периферия	Анонс
MT8786 (Helio G80T)	12 нм	2x Cortex-A75 2 ГГц 6x Cortex-A55 1,8 ГГц	Mali-G52 MC2	4G LTE Cat-7 DL/Cat-13 UL, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n/ac, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, 48Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP-9	2021
MT8788		4x Cortex-A73 2 ГГц 4x Cortex-A53 2 ГГц	Mali-G72 MP3	4G LTE Cat-7 DL/Cat-5/6 UL, Bluetooth, FM, Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 32Мп ISP, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	2020

Мультимедиа-процессоры

Название	Техпроцесс	Кол-во ядер, архитектура ARM, частота	Архитектура GPU	Периферия	Анонс
MT8581	28 нм	4x Cortex-A53 1,3 ГГц	Mali-T860 MP2	H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), VP-8, VP-9	2016
MT8685		4x Cortex-A7 1,5 ГГц	Mali-450 MP4	Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), VP-8	2016
MT8693		2x Cortex-A72 2 ГГц 4x Cortex-A53 1,8 ГГц	PowerVR GX6250	Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, H.264 (AVC) и H.265 (HEVC)	2016

GPS-чипы

- MT6620 — Bluetooth, FM-приемник и передатчик
- MT6628Q — Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth (3.0+HS и 4.0), GPS/QZSS/SBAS и FM-приемник с поддержкой RDS
- MT6628T — Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth (3.0+HS и 4.0) и FM-приемник с поддержкой RDS
- MT3339 (2011)
- MT3326
- MT3337
- MT3336
- MT3333/MT3332 (2013) Поддерживает работу с GPS+Глонасс (или Galileo)
- MT3329/MT3339 (2013) Только GPS
- MT3328

См. также

- [Snapdragon \(SoC\)](#)

- [Samsung Exynos](#)
- [Nvidia Tegra](#)
- [TI OMAP](#)
- [Apple Ax](#)
- [HiSilicon K3](#)
- [NovaThor \(SoC\)](#)
- [Rockchip \(SoC\)](#)
- [Adreno \(GPU\)](#)
- [PowerVR \(GPU\)](#)
- [Mali \(GPU\)](#)

Примечания

1. [Foxconn Technology Co Ltd \(2354.TW\) - Quote](https://www.reuters.com/companies/2454.TW) (<https://www.reuters.com/companies/2454.TW>) (англ.). Reuters. Дата обращения: 24 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210110001232/https://www.reuters.com/companies/2454.TW>) 10 января 2021 года.
2. [MediaTek Annual Report 2020](https://cdn-www.mediatek.com/posts/2020-MediaTek-Annual-Report0121.pdf) (<https://cdn-www.mediatek.com/posts/2020-MediaTek-Annual-Report0121.pdf>) (англ.)
3. [Yahoo! Finance MediaTek Inc. \(2454.TW\) Stock Key Data](https://finance.yahoo.com/quote/2454.TW/) (<https://finance.yahoo.com/quote/2454.TW/>) (англ.)
4. *Daniel R. Deakin*. [MediaTek leapfrogs Qualcomm as the world's largest smartphone chipset vendor thanks to huge growth in India and Latin America](https://www.notebookcheck.net/MediaTek-leapfrogs-Qualcomm-as-the-world-s-largest-smartphone-chipset-vendor-thanks-to-huge-growth-in-India-and-Latin-America.512177.0.html) (<https://www.notebookcheck.net/MediaTek-leapfrogs-Qualcomm-as-the-world-s-largest-smartphone-chipset-vendor-thanks-to-huge-growth-in-India-and-Latin-America.512177.0.html>) (англ.). Notebookcheck. Дата обращения: 25 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210126231732/https://www.notebookcheck.net/MediaTek-leapfrogs-Qualcomm-as-the-world-s-largest-smartphone-chipset-vendor-thanks-to-huge-growth-in-India-and-Latin-America.512177.0.html>) 26 января 2021 года.
5. [MediaTek breaks into Mobile Phones](https://www.ft.com/intl/cms/s/0/6fbf3994-440a-11e0-8f20-00144feab49a.html#axzz1RTc7gCM1) (<https://www.ft.com/intl/cms/s/0/6fbf3994-440a-11e0-8f20-00144feab49a.html#axzz1RTc7gCM1>) (англ.). Архивировано (https://www.webcitation.org/6BqQnyLtq?url=http://www.ft.com/cms/s/0/6fbf3994-440a-11e0-8f20-00144feab49a,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F6fbf3994-440a-11e0-8f20-00144feab49a.html#axzz1RTc7gCM1) 1 ноября 2012 года.
6. [Investor FAQ,MediaTek](http://www.mediatek.com/en/Investor/faq.php) (<http://www.mediatek.com/en/Investor/faq.php>) (англ.). Архивировано (<https://www.webcitation.org/6BqQovNjw?url=http://www.mediatek.com/en/Investor/faq.php>) 1 ноября 2012 года.
7. [MediaTek Inc. 2009 Annual Report](http://www.mediatek.com/upload/files/c8711ebbeb0a0d59e38f00d0c16420c3.pdf) (<http://www.mediatek.com/upload/files/c8711ebbeb0a0d59e38f00d0c16420c3.pdf>) (англ.). MediaTek. Дата обращения: 19 января 2011. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6BqQj54Xt?url=http://www.mediatek.com/upload/files/c8711ebbeb0a0d59e38f00d0c16420c3.pdf>) 1 ноября 2012 года.
8. [Mediatek: cheap, super fast processors will change the smartphone market forever](https://www.cellalpha.com/mediatek-helio-g90-and-g90t/) (<https://www.cellalpha.com/mediatek-helio-g90-and-g90t/>) (англ.), Hot Topics (27 November 2014). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141203095600/http://www.hottopics.ht/stories/consumer/get-ready-for-super-mid-market-smartphone-revolution/>) 3 декабря 2014 года. Дата обращения: 27 ноября 2014.
9. [Chaos reigns in Top20 Semiconductor Company Ranking](https://evertiq.com/news/14176) (<https://evertiq.com/news/14176>) (англ.) (15 мая 2009). Дата обращения: 20 ноября 2009. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6BqQxJRfh?url=http://evertiq.com/news/14176>) 1 ноября 2012 года.
10. [MediaTek merges with Ralink Technology Corp.](http://www.mediatek.com/en/News/news_content.php?sn=1018) (http://www.mediatek.com/en/News/news_content.php?sn=1018) Архивировано (https://www.webcitation.org/6BqQyO0yU?url=http://www.mediatek.com/en/News/news_content.php?sn=1018) 1 ноября 2012 года.
11. [“MediaTek buys baseband DSP IP licensor Coresonic”](https://web.archive.org/web/20131005013910/http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1261529) (https://web.archive.org/web/20131005013910/http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1261529). *EE Times* [англ.]. Архивировано из оригинала (http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1261529) 2013-10-05. Дата обращения 2013-10-03.
12. [MediaTek raises Q1 sales forecast on merger with MStar](http://focustaiwan.tw/news/aeco/201402180013.aspx) (<http://focustaiwan.tw/news/aeco/201402180013.aspx>) (англ.). Focus Taiwan. Дата обращения: 7 мая 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140508061855/http://focustaiwan.tw/news/aeco/201402180013.aspx>) 8 мая 2014 года.

13. *Jackson Chang, Frances Huang*. MediaTek 4th largest IC designer worldwide in 2013 (<http://focustaiwan.tw/news/aeco/201405100012.aspx>) (англ.) (10 May 2013). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140808040952/http://focustaiwan.tw/news/aeco/201405100012.aspx>) 8 августа 2014 года. Дата обращения: 31 июля 2014.
14. MediaTek предсказали первое место на мировом рынке мобильных процессоров в 2021 году (<https://3dnews.ru/1036630>). *3DNews - Daily Digital Digest* (6 апреля 2021). Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210504172347/https://3dnews.ru/1036630>) 4 мая 2021 года.
15. Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel (https://www.cnews.ru/news/top/2022-11-09_kompaniyagodami_obmanuvavshaya). *CNews.ru* (9 ноября 2022). Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20221114182640/https://www.cnews.ru/news/top/2022-11-09_kompaniyagodami_obmanuvavshaya) 14 ноября 2022 года.
16. *Lenovo picks MediaTek Chips* (<http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2012/09/15/2003542772>). Архивировано (<https://www.webcitation.org/6BqQmVcXW?url=http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2012/09/15/2003542772>) 1 ноября 2012 года.
17. *Mediatek.com: 25 May 1995: Garmin Selects MediaTek GPS Chipsets for Outdoor Navigation Devices* (<http://www.mediatek.com/en/news/info.php?sn=15>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110728144737/http://www.mediatek.com/en/news/info.php?sn=15>) 28 июля 2011 года.
18. MediaTek станет четвёртым в мире разработчиком чипов без собственных мощностей (<https://3dnews.ru/news/631445>). *3DNews - Daily Digital Digest* (27 июня 2012). Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160911091401/https://3dnews.ru/news/631445>) 11 сентября 2016 года.
19. *MTK Phonesuite for various mobiles* (<http://www.techday.in/2012/04/pc-suite-for-china-mobile-and-how-to-run-internet-from-china-mobile/>) (2 апреля 2012). Дата обращения: 14 сентября 2012. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6BqQt82Zb?url=http://www.techday.in/2012/04/pc-suite-for-china-mobile-and-how-to-run-internet-from-china-mobile/>) 1 ноября 2012 года.
20. *MediaTek unseats TI as No.2 cellular baseband chip vendor* (<http://www.thefreelibrary.com/MediaTek+unseats+TI+as+No.2+cellular+baseband+chip+vendor.-a0221919286>) (15 марта 2010). Дата обращения: 30 июня 2010. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6BqQtldde?url=http://www.thefreelibrary.com/403.htm>) 1 ноября 2012 года.
21. Компания, годами обманывавшая весь мир, ищет замену Тайваню для выпуска чипов. В фокусе — американская Intel (https://www.cnews.ru/news/top/2022-11-14_kompaniyagodami_obmanuvavshaya). *CNews.ru* (14 ноября 2022). Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20221114225151/https://www.cnews.ru/news/top/2022-11-14_kompaniyagodami_obmanuvavshaya) 14 ноября 2022 года.
22. *Intel and MediaTek Form Foundry Partnership* (<https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1561/intel-and-mediatek-form-foundry-partnership>) (англ.). *Intel Corporation*. Дата обращения: 26 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220726073943/https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1561/intel-and-mediatek-form-foundry-partnership>) 26 июля 2022 года.
23. *Intel будет производить процессоры MediaTek* (https://mobiltelefon.ru/post_1658804607.html). *mobiltelefon.ru*. Дата обращения: 26 июля 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220726043721/https://mobiltelefon.ru/post_1658804607.html) 26 июля 2022 года.
24. *MediaTek хочет покорить автомобильный рынок: компания представила чип Dimensity Auto* (<https://trashbox.ru/link/2023-04-18-kompaniya-predstavila-chip-dimensity-auto>). *Трешбокс.ру*. Дата обращения: 19 апреля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230419102347/https://trashbox.ru/link/2023-04-18-kompaniya-predstavila-chip-dimensity-auto>) 19 апреля 2023 года.
25. *MediaTek внедрит генеративный ИИ от Meta* в процессоры для смартфонов* (<https://3dnews.ru/1091903/mediatek-i-meta-vnedryat-generativniy-ii-v-chipseti-smartfonov>). *3dnews.ru*. Дата обращения: 23 августа 2023.
26. *MediaTek MT6517 Multi-core Application Processor with Modem* (http://pdadb.net/index.php?m=cru&id=a6517&c=mediatek_mt6517) (англ.). Дата обращения: 30 марта 2013. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6Fz6k1uwX?url=http://pdadb.net/index.php?m=cru>) 19 апреля 2013 года.
27. *MediaTek Strengthens Global Position with Worlds First Quad-Core Cortex-A7 System on a Chip MT6572* (http://pdadb.net/index.php?m=cru&id=a6572&c=mediatek_mt6572) (англ.). *mediatek.com* (11 декабря 2012). Дата обращения: 30 марта 2013. Архивировано (https://www.webcitation.org/6Fz6odif?url=http://www.mediatek.com/_en/03_news/01-2_newsDetail.php?sn=1088) 19 апреля 2013 года.
28. Популярно о железе: китайские мобильные процессоры (<http://www.mforum.ru/phones/tests/102178.htm>). Мобильный форум (1 ноября 2012). Дата обращения: 30 марта 2013. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6Fz6I7yHT?url=http://www.mforum.ru/phones/tests/102178.htm>) 19 апреля 2013 года.
29. *MediaTek Strengthens Global Position with World's First Quad-Core Cortex-A7 System on a Chip – MT6589* (https://www.webcitation.org/6Fz6odif?url=http://www.mediatek.com/_en/03_news/01-2_newsDetail.php?sn=1088) (англ.). *mediatek.com* (11 декабря 2012). Дата обращения: 30 марта 2013. Архивировано из оригинала (http://www.mediatek.com/_en/03_news/01-2_newsDetail.php?sn=1088) 19 апреля 2013 года.
30. *MediaTek MT6582 RISC Multi-core Application Processor with Modem* (http://pdadb.net/index.php?m=cru&id=a6582&c=mediatek_mt6582) (англ.) (28 октября 2013). Дата обращения: 10 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140104133028/http://pdadb.net/index.php?m=cru&id=a6582&c=mediatek_mt6582) 4 января 2014 года.

31. *Rosgani*. 2.0GHz MediaTek MT6592 performance test (<http://www.gizmochina.com/2014/03/04/2-0ghz-mediatek-mt6592-performance-test/>) (4 марта 2014). Дата обращения: 26 июня 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140517122930/http://www.gizmochina.com/2014/03/04/2-0ghz-mediatek-mt6592-performance-test/>) 17 мая 2014 года.
32. Восьмиядерная платформа MediaTek MT6592 располагает GPU Mali-450 (<https://web.archive.org/web/20160304072848/http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17%2F27%2F34>) (17 октября 2013). Архивировано из оригинала (<http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/27/34>) 4 марта 2016 года.
33. 马小哥. 内建MALI-450? 疑似MTK6592手机跑分性能曝光 (<http://www.mtksj.com/html/mtkshoujizixun/5207.html>) (кит.) (14 октября 2013). Дата обращения: 17 октября 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131017212903/http://www.mtksj.com/html/mtkshoujizixun/5207.html>) 17 октября 2013 года.
34. MediaTek Set To Unveil MT6290 Quad-Core Processor, Supports 4G LTE Connections (<http://www.gizchina.com/2013/05/27/mediatek-speaks-about-its-4g-lte-mt6290-soc/>). gizchina. Дата обращения: 27 мая 2013. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6l0055li0?url=http://www.gizchina.com/2013/05/27/mediatek-speak-s-about-its-4g-lte-mt6290-soc/>) 10 июля 2013 года.
35. MTK MT6595完整规格解密 (<http://www.mtksj.com/html/mtkshoujizixun/7260.html>) (3 апреля 2014). Дата обращения: 26 июня 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140701155624/http://www.mtksj.com/html/mtkshoujizixun/7260.html>) 1 июля 2014 года.
36. MediaTek Helio P30 (<https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-p30>). Дата обращения: 16 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200404015921/https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-p30>) 4 апреля 2020 года.
37. MediaTek Helio P35 (<https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-p35>). Дата обращения: 31 декабря 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181225080839/https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-p35>) 25 декабря 2018 года.
38. MediaTek Helio P70 (<https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-p70>). Дата обращения: 24 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200404015454/https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-p70>) 4 апреля 2020 года.
39. MediaTek Helio X27 (<https://www.mediatek.com/products/smartphones/mt6797x-helio-x27>). Дата обращения: 16 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200812235310/https://www.mediatek.com/products/smartphones/mt6797x-helio-x27>) 12 августа 2020 года.
40. MediaTek | Dimensity | 5G Smartphone Chips (<https://www.mediatek.com/products/smartphones/dimensity-5g>) (англ.). *MediaTek*. Дата обращения: 8 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220705072622/https://www.mediatek.com/products/smartphones/dimensity-5g>) 5 июля 2022 года.

Ссылки

- [mediatek.com \(http://www.mediatek.com/\)](http://www.mediatek.com/) — официальный сайт MediaTek
- [Каталог всех процессоров и чипов MediaTek \(https://mediatek-club.ru/publ/mediatek_chipset_info/katalog_vsekh_processorov_mediatek/1-1-0-90\)](https://mediatek-club.ru/publ/mediatek_chipset_info/katalog_vsekh_processorov_mediatek/1-1-0-90)
- [datasheet ряда процессоров MT62xx \(https://web.archive.org/web/20140603153256/http://www.kit-iphone.ru/2010-06-03-10-23-04/datasheet.html\)](https://web.archive.org/web/20140603153256/http://www.kit-iphone.ru/2010-06-03-10-23-04/datasheet.html) /вебархив/
- [Сравнительная таблица ARM процессоров \(http://technodaily.ru/?p=6412\)](http://technodaily.ru/?p=6412) // Technodaily.ru

Источник — <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaTek&oldid=134240270>

Эта страница в последний раз была отредактирована 14 ноября 2023 в 19:01.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
 Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Фонд Викимедиа (Wikimedia Foundation, Inc.)